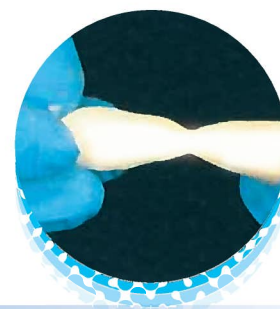


柔らかい・低粘着・伸ばせる

自由自在に成型可能な高絶縁・熱伝導部材



特徴

◎柔らかい粘土状

- 変形自由度が高い
- 立体、曲面、複雑空間を埋める

◎低粘着で取扱性、リワーク性に優れる

- 常温で流れない、高温でもポンプアウトしない
- 工程が汚れない、設置部位を汚さない

◎電気絶縁性あり

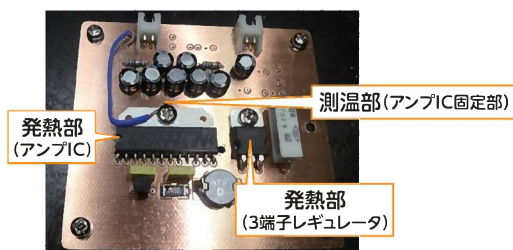
- 電気回路、電子部品周辺で使用可能

◎シロキサンレスグレードを追加 ※試作品となります

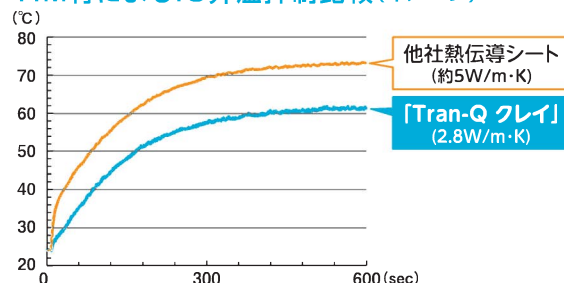
- 低分子シロキサン含有 50ppm(実測値)でリスクマネジメントが可能に

約5W/m・Kのシートよりも優れた熱伝導効率 ※自社評価による

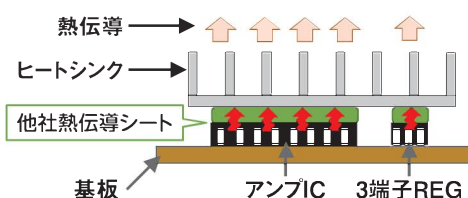
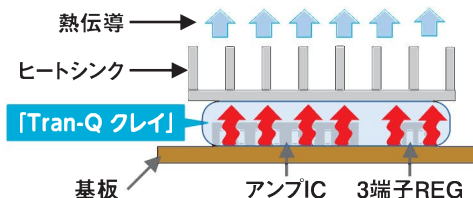
基板発熱部および測温部



TIM材によるIC昇温抑制比較(イメージ)



TIM設置構成



■販売形態

●包装仕様イメージ写真



「Tran-Q クレイ」500g



「Tran-Q クレイ」50g

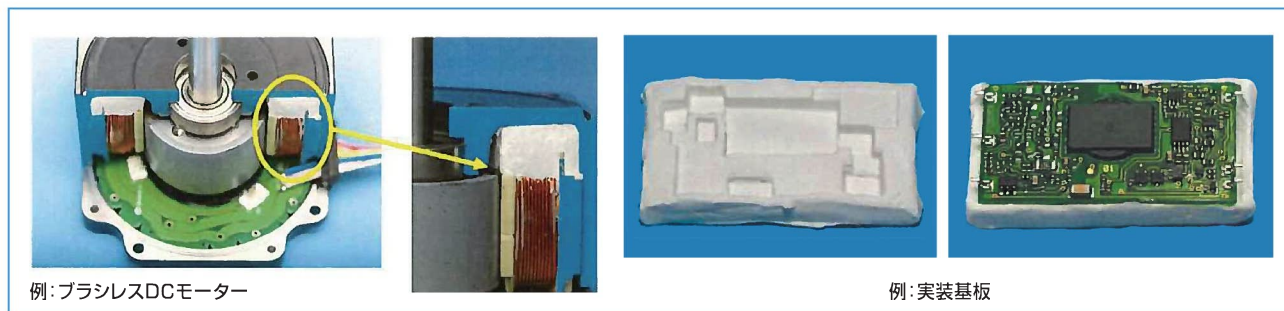


「Tran-Q クレイ」シロキサンレス50g

Tran-Q クレイ
トラン・キュー

■適用例

モーター巻線のすきま、基板凹凸面とヒートシンク間の空隙



■代表特性

項目		単位	共通			試験方法
色		—	白			—
比重		—	2.8			—
硬さ(不混和ちょう度)		—	120			JIS K 2220
熱伝導率		W/m・K	2.8			熱線法
推奨使用温度		℃	-40~200			—
体積抵抗率		Ω・cm	>2.7×10 ¹³			JIS K 6249(前処理 105℃/24h)
絶縁破壊強さ(AC)		kV/mm	7.6			JIS C 2110
耐電圧(1min)		kV/mm	6.5			JIS C 2110
誘電特性	周波数	(Hz)	100Hz	1kHz	1MHz	—
	比誘電率	—	6.2	6.0	5.9	JIS C 2138
	誘電正接	—	0.023	0.011	0.006	JIS C 2138
難燃性		—	V-0相当			UL94 V

項目	単位	「Tran-Q クレイ」シロキサンレス	試験方法
低分子シロキサン(D3 D10) ※実測値	ppm	≤50	評価条件 140℃×10min(GC/MS)

※NOK「Tran-Q クレイ」、「Tran-Q クレイ」シロキサンレスは、REACH規制に準拠、RoHS指令に対応しています。

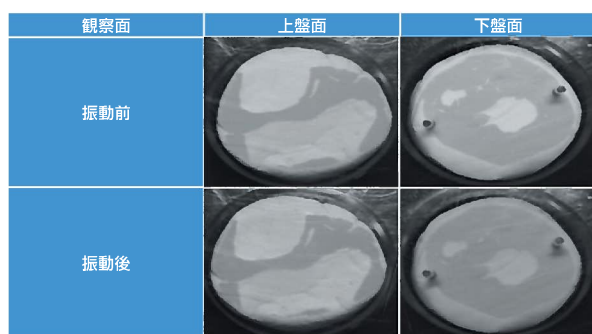
※シロキサンレスグレードは開発中の商品です。

■代表特性環境試験変化

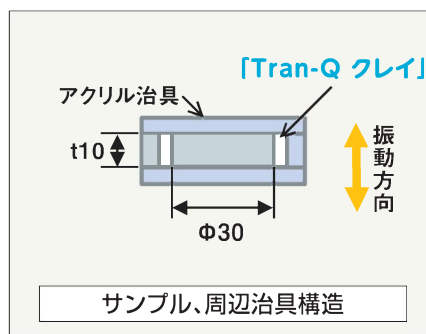
項目	単位	未処理	-40℃ (1,000h)	200℃ (1,000h)	85℃/95%Rh (1,000h)	-40℃⇔150℃ (各30min×1,000サイクル)
硬さ(不混和ちょう度)	—	120	115	130	185	125
熱伝導率	W/m・K	2.8	2.9	3.0	2.9	3.0
絶縁破壊電圧(AC)	kV/mm	7.6	8.7	8.2	7.7	8.0
体積抵抗率	Ω・cm	>2.7×10 ¹³	1.5×10 ¹²	>2.7×10 ¹³	2.3×10 ¹²	>2.7×10 ¹³

■振動試験結果

「Tran-Q クレイ」を挟んだ盤面との接触(変形)状態を振動試験前後で比較



振動による盤面からの剥がれや形状変化なし



【試験条件】
参考規格:ISO16750-3
振動時間:8時間
振動種類:ランダム振動
試験温度:R.T.

●製品取扱上の注意点 ●記載された情報およびデータは、規格値および保証値ではありません。●人体・動物に移植したり、体液や生体組織に接触する医療用器具用途には使用しないでください。●食品ではありませんので、口に入れたり飲み込んだりしないでください。●製品中のシリコンオイルがブリードすることがありますので、問題ない箇所でご使用ください。●製品を廃棄する場合には、国および各自治体の法令に従って廃棄してください。●本カタログの記載内容は断りなく変更することがあります。